

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61190-1-2**

Première édition  
First edition  
2002-03

---

---

**Matériaux de fixation pour les  
assemblages électroniques –**

**Partie 1-2:  
Exigences relatives aux crèmes de brasage  
pour les interconnexions de haute qualité  
dans les assemblages de composants  
électroniques**

**Attachment materials for electronic assembly –**

**Part 1-2:  
Requirements for solder pastes  
for high-quality interconnections in  
electronics assembly**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61190-1-2:2002